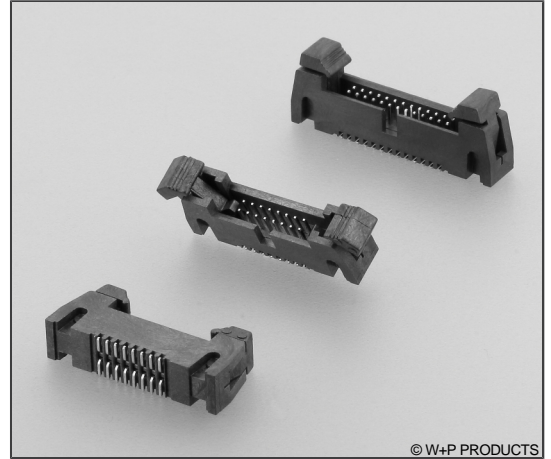


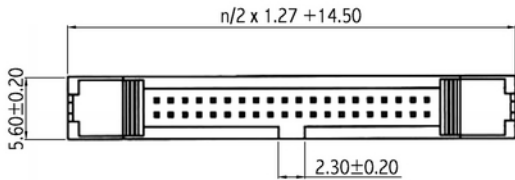
SMT-Wannenstiftleisten mit Verriegelung RM 1,27mm, stehend SMT Box Headers with Latches, 1.27mm Pitch, Vertical

Technische Daten / Technical Data

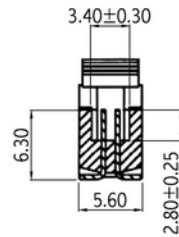
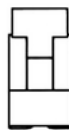
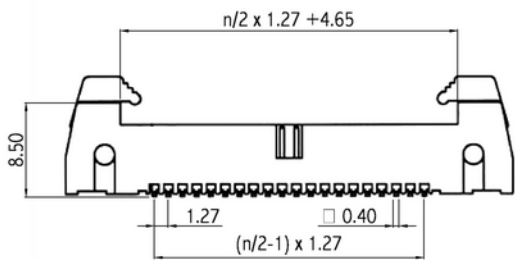
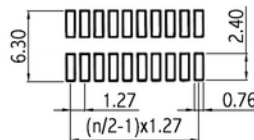
Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
<i>Insulator</i>	<i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial	Messing
<i>Contact Material</i>	<i>Brass</i>
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
<i>Contact Surface</i>	<i>Acc. to options (see below), over Ni</i>
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
<i>Contact Resistance</i>	<i>< 20 mΩ</i>
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
<i>Insulation Resistance</i>	<i>> 1000 MΩ</i>
Spannungsfestigkeit	300 V AC
<i>Test Voltage</i>	<i>300 V AC</i>
Nennstrom	1 A
<i>Current Rating</i>	<i>1 A</i>
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
<i>Temperature Range</i>	<i>-40 °C ... +105 °C</i>
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
<i>Processing</i>	<i>Reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS



PCB Layout



Series

3370

Contacts*

012

006 010 012 014 016
020 026 030 034 040
044 050 060 068

Plating

00

00 Vergoldet
Gold plated

Packing

ST

ST In Stangen ohne Pick&Place-Pads
In tubes w/o Pick&Place-Pads

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Lötten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

